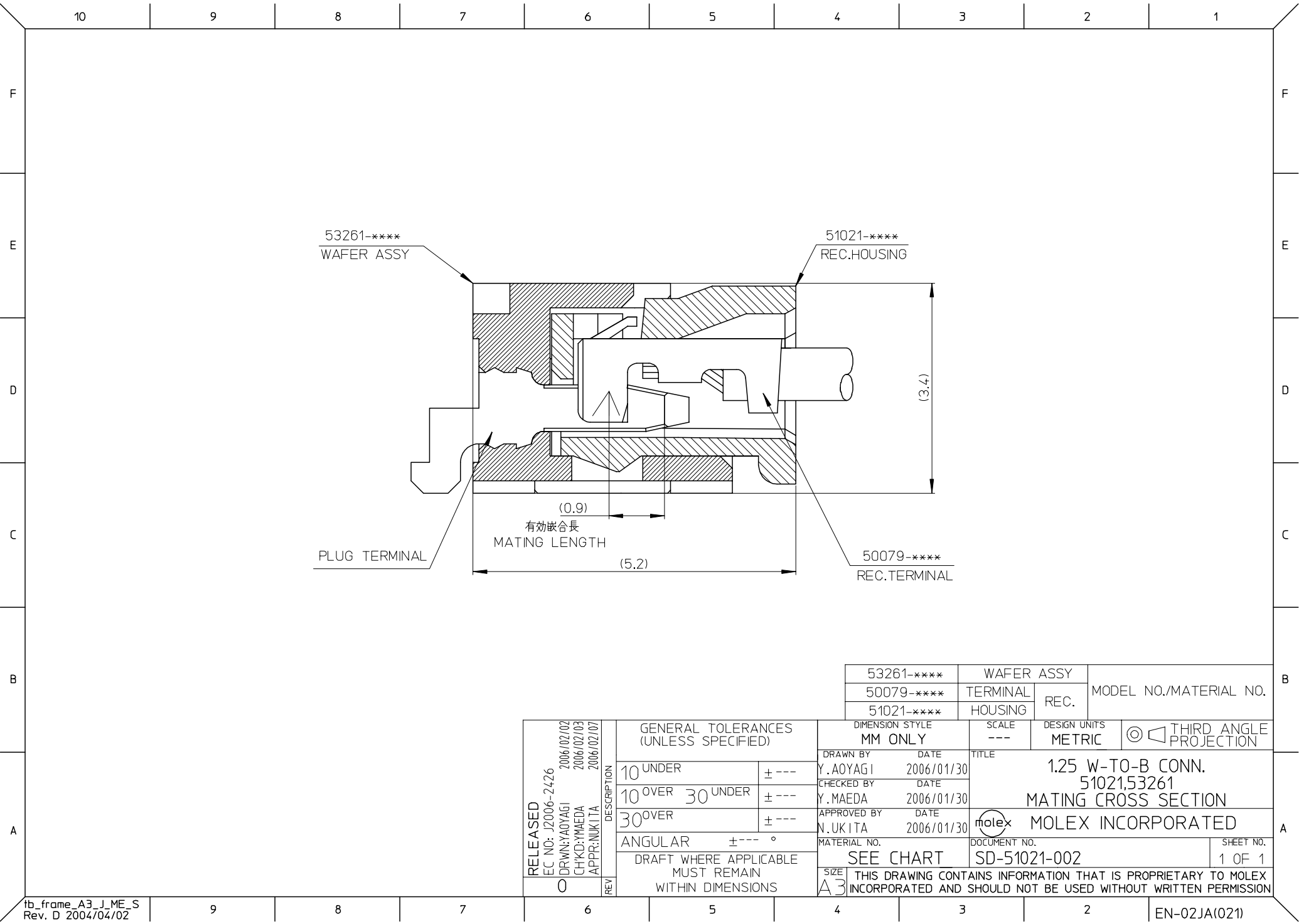
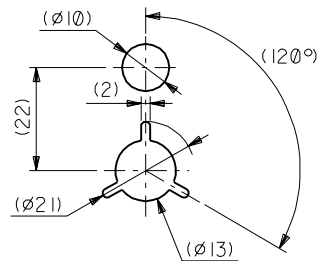


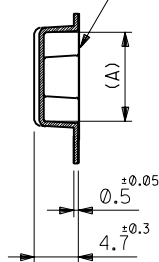


53261-****	WAFER ASSY	MODEL NO./MATERIAL NO.
50079-****	TERMINAL	
51021-****	HOUSING	

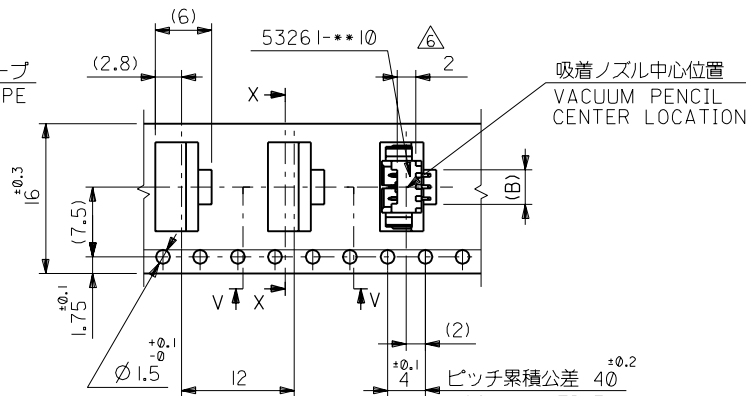
RELEASED EC NO: J2006-2426 DRWN: YAOYAGI 2006/02/02 CHKD: YMAEDA 2006/02/03 APPR: NUKITA 2006/02/07 REV 0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY Y. AOYAGI	DATE 2006/01/30	TITLE 1.25 W-TO-B CONN. 51021,53261 MATING CROSS SECTION				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY Y. MAEDA	DATE 2006/01/30					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2006/01/30	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.			DOCUMENT NO.			SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART			SD-51021-002			1 OF 1
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

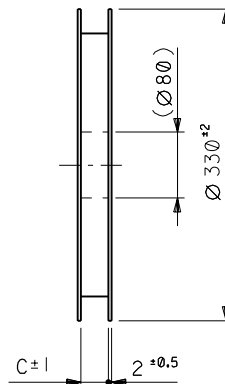
DETAIL "F"

トップテープ
TOP TAPE

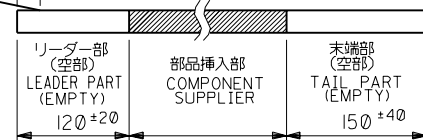
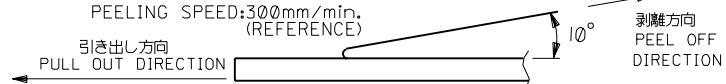
SECT:X-X

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

SECT:V-V

注記
NOTES1. 53261-**-10 の詳細寸法については図面 SD-53261-**-10 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53261-**-10.2. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープリーダー部 TOP TAPE LEADER PART
トップテープ未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART
175 ±25 25 ±5引き出し方向
PULL OUT DIRECTION4. トップテープの剥離強度: 0.1N~0.59N(10.2~60gf) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1N~0.59N(10.2~60gf)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)<剥離速度: 300mm/min (参考)>
PEELING SPEED: 300mm/min. (REFERENCE)

5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)

トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF

リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材含む>

POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

△ コネクタ、ハウジング平面部
CONNECTOR, HOUSING FLAT AREA

16	16.4	3.7	9.5	53261-0390	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	2.45	8.25	53261-0290	2
	B	A	ENG. NO.		極致 CKT.

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGEDRAWN BY '93/6/1
K.TOJO
CHK'D BY '00/12/8
T.YAMAGUCHI
APP'D BY '00/12/8
M.FUKUSHIMA
尺度
SCALEmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.25 WIRE TO BOARD CONN.

WAFER ASS'Y FOR SMT.

EMBOSSD TAPE PACKAGE

DWG. NO. SHEET 1 OF 3 REV

SD-53261-**-90 F

角度 ANGLE	±3°				
30°以上 OVER	±0.3				
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	F	変更 REVISED	UC2001-0437	S.M.T. '00/12/8
10°未満 UNDER	±0.2	E	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN	(J30522)	K.T. '93/6/1
般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

トップテープ
TOP TAPE

(6)

53261-**-10

(2.8)

Z

△6

2

吸着ノズル中心位置
VACUUM PENCIL CENTER LOCATION

(A)

24^{+0.3}

(11.5)

±0.1

1.75

±0.05

0.5

±0.3

4.7

SECT:Z-Z

±0.1

12

T

Z

T

(2)

±0.1

4

±0.2

40

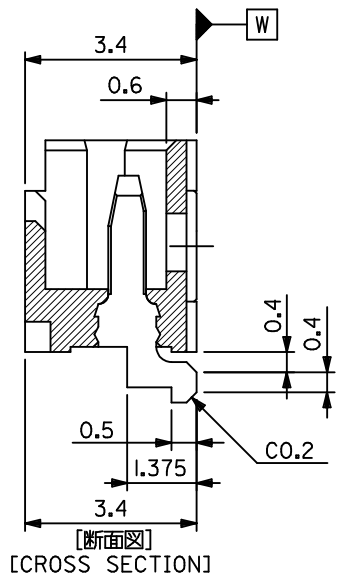
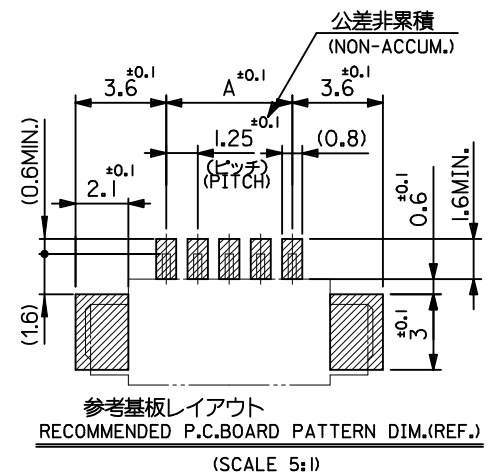
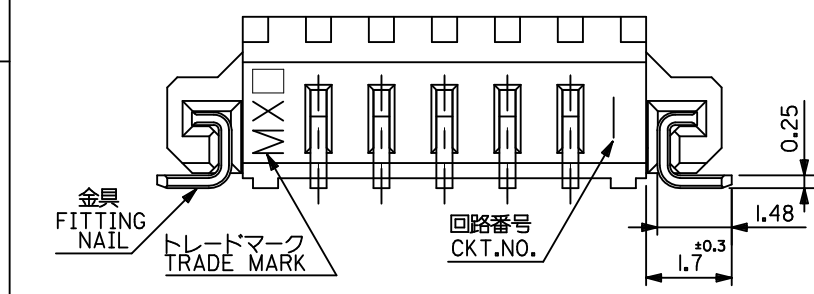
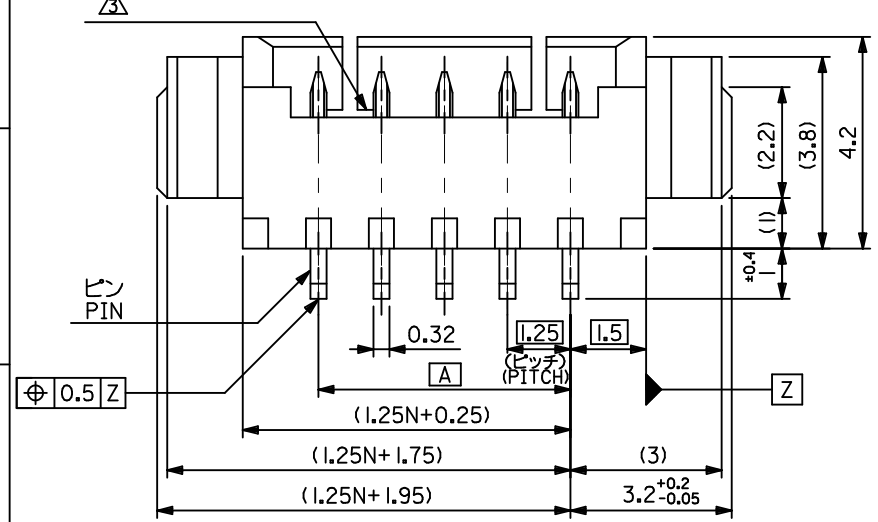
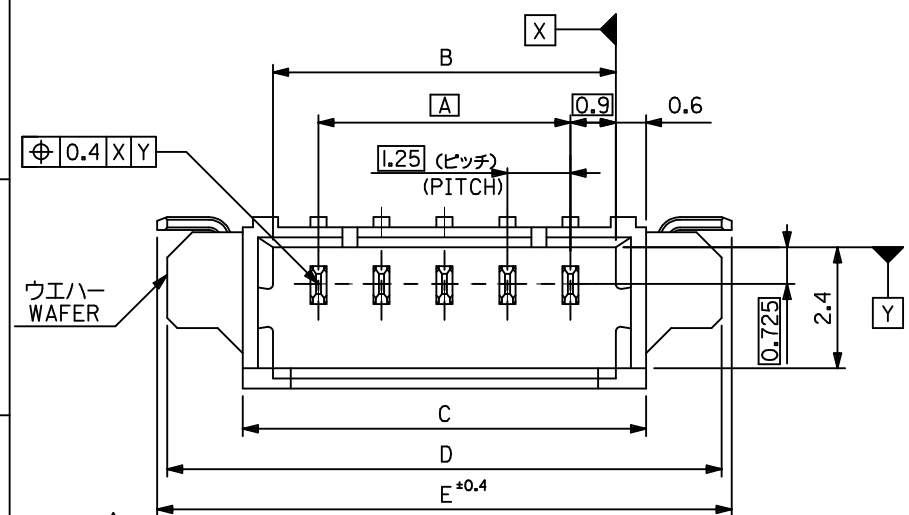
ピッチ累積公差
ACCUMULATIVE PITCH 40 ±0.2

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

角度 ANGLE	±30				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	F	変更 REVISED (J305220) (J305221)	S.M.	10/12/8
10 未満 UNDER	±0.2	E	変更及び再作図 REVISED&REDRAW (J305222)	K.T. H.H.	93/6/1
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 TR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE	—	I.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR SMT. EMBOSSED TAPE PACKAGE	
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO	CHK'D BY '00/12/8 T.YAMAGUCHI	DWG. NO.	
APP'D BY '00/12/8 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —	SHEET 2 OF 3	REV
		SD-53261-**90	F

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(032)MX-J-32



[CROSS SECTION]

- 注記 NOTES
1. 嵌合相手: 51021 シリウス
MATES WITH: 51021 SERIES
 2. 材質 MATERIAL
ウエハー: NYLON46, UL94V-0
ピン: リン青銅, 半田メッキ
PIN: PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 3 μmMIN.
OVER Cu 1 μmMIN.
PLATING
金具: リン青銅, 半田メッキ
FITTING NAIL: PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 2 μmMIN.
OVER Cu 1 μmMIN.
PLATING
 3. ロック窓は2、3極は1箇所、4極以上は2箇所とする。
LOCKING WINDOW: ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKT. AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
 4. ソルダテール部のズレ量及び金具(補強板)のズレ量は基準面 W に対し、上方向 0.05 MAX.、下方向に 0.1 MAX. とする。
OFFSET BETWEEN BASIS PLANE W TO SOLDER TAIL BOTTOM AND FITTING NAIL BOTTOM: UPPER SIDE: 0.05MAX. LOWER SIDE: 0.1MAX.

23.9	23.5	20.5	19.3	17.5	53261-1510	15
22.65	22.25	19.25	18.05	16.25	-1410	14
21.4	21	18	16.8	15	-1310	13
20.15	19.75	16.75	15.55	13.75	-1210	12
18.9	18.5	15.5	14.3	12.5	-1110	11
17.65	17.25	14.25	13.05	11.25	-1010	10
16.4	16	13	11.8	10	-0910	9
15.15	14.75	11.75	10.55	8.75	-0810	8
13.9	13.5	10.5	9.3	7.5	-0710	7
12.65	12.25	9.25	8.05	6.25	-0610	6
11.4	11	8	6.8	5	-0510	5
10.15	9.75	6.75	5.55	3.75	-0410	4
8.9	8.5	5.5	4.3	2.5	-0310	3
7.65	7.25	4.25	3.05	1.25	53261-0210	2
E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO: J2012-1315 2012/04/17 DRWN: NITO CHKD: KASAKAWA 2012/04/17 APPR: YOITO 2012/04/26	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) 10 UNDER ±0.2 10 OVER 30 UNDER ±0.25 30 OVER ±0.3 ANGULAR ±3 ° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	DIMENSION STYLE MM ONLY DRAWN BY DATE NITO 2012/04/17 CHECKED BY DATE KASAKAWA 2012/04/17 APPROVED BY DATE YOITO 2012/04/26 MATERIAL NO. SEE DRAWING SIZE A3	SCALE 10:1 DESIGN UNITS METRIC THIRD ANGLE PROJECTION 1.25 WIRE TO BOARD WAFER ASS FOR SMT RIGHT ANGLE molex SD-53261-054 SHEET NO. 1 OF 1
---	--	---	---